

公司代码：688183

公司简称：生益电子

生益电子股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在报告全文中详细的描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632 万元，母公司实现净利润-5,200.8333 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定公积金，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 64,557.6724 万元。结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。该利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	唐慧芬	朱宝玲
办公地址	广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
电话	0769-89281988	0769-89281988
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一） 主要业务、主要产品或服务情况

公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

（二） 主要经营模式

公司的客户主要聚焦在通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户合同需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于 PCB 规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：

1、盈利模式

公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化 PCB 产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，使用最优的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的 PCB 产品，销售给境内外客户。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式，即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。

公司采购原材料时通过 SRM（供应商关系管理）系统在线广泛寻源，向供应商询价并对样品进行检验并封样，在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后，选择优质供应商资源，安排采购订单，并通过 SRM 系统实现采购业务全过程的闭环管理，建立了科学、有竞争力的采购供应体系。

公司对合格供应商执行严格的管理要求，并制定了《供应商管理工作程序》，通过 SRM 系统，实现供应商全生命周期的线上闭环管理。供应链管理负责制定并维护认可供应商清单，对供应商制定年度审核和全面提升计划，根据供应商的技术、质量、交付、服务、成本等进行多维度的考核并提出提升要求。公司认真培养合格供应商，利用公司技术优势，与合格供应商加强技术合作，提升产品能力，实现供应链的双赢，并与战略供应商达成战略伙伴关系，让供应链具备竞争优势。

3、生产模式

由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行 PCB 产品研发，为客户提供性能优异的 PCB 产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备，并为客户提供最优的可制造方案，与客户建立长期稳定的合作关系。

4、销售模式

根据公司的技术能力和产品定位，对标各行业的重点客户进行合作。通过对客户类型和 PCB 市场应用情况的分析，公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指通过 PCB 贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司各职能部门按照客户需求进行分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。

PCB 诞生于 20 世纪 30 年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展，PCB 的应用将越来越广泛。

PCB 产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：

(1) 按线路图层数进行分类

产品种类	简介
单面板	最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，所以称为单面板，主要应用于较为早期的电路。
双面板	在绝缘基板两面均有导电图形，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来，此类 PCB 可以通过金属孔使布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电路上。
多层板	有四层或四层以上导电图形的印制电路板，内层是由导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成，外层为铜箔，经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印刷导线引出，多层板上安装元件的孔（即导孔）需经金属化孔处理，使之与夹在绝缘基板中的印刷导线连接。多层板导电图形的制作以感光法为主。层数通常为偶数，并且包含最外侧的两层。

(2) 按产品结构进行分类

产品种类	产品特性	应用领域
刚性板（硬板）	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。	广泛分布于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等行业。
挠性板（软板）	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接一体化。	智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。
刚挠结合板	指在一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将薄层状的挠性印制电路板底层和刚性印制电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。	先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。
HDI 板	High Density Interconnect 的缩写，即高密度互连技术，是印制电路板技术的一种。HDI 板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印刷电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。相较于传统多层印制板，HDI 板可提高板件布线密度，有利于先进封装技术的使用；可使信号输出品质提升；还可以使电子产品在外观上变得更为小巧方便。	主要是高密度需求的消费电子领域，广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车电子和其他数码产品等，其中以手机的应用最为广泛。目前通信产品、网络产品、服务器产品、汽车产品甚至航空航天产品都有用到 HDI 技术。
封装基板	即 IC 封装基板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。	在智能手机、平板电脑等移动通信产品领域，封装基板得到了广泛的应用。如存储用的存储芯片、传感用的微机电系统、射频识别用的射频模块、处理器芯片等器件均要使用封装基板。而高速通信封装基板已广泛应用于数据宽带等领域。

(3) 按产品用途进行分类

产品种类	简介
通信设备板	主要应用于移动通信基站及周边信号传输产品等通信设备上的各类印制电路板。
网络设备板	主要应用于骨干网传输、路由器、高端交换机、以太网交换机、接入网等网络传输产品。
计算机/服务器板	主要应用于各式服务器及网络计算机等领域。
汽车电子板	主要应用于汽车安全、中控及高端娱乐系统、电动能源管理系统、自动驾驶传感及毫米波雷达等产品。
消费电子板	主要应用于智能手机及其配套设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的电子产品。
工控设备板	主要应用于嵌入式主板、工业电脑等。
医疗器械板	主要应用在 CT、核磁共振仪、超声、呼吸机等。
航空航天板	主要应用于航电系统和机电系统，其中航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通信、监视与告警等功能系统；机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统等功能系统。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 公司所处行业地位

印制电路板的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。生益电子成立于 1985 年，长期专注并深耕于印制电路板行业，产品以通讯网络、计算机/服务器、汽车电子等应用领域的印制线路板为主，兼顾了消费电子、工控医疗、航空航天等领域知名企业的重要产品，属于中国印制线路板行业领先企业之一。根据 CPCA 发布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业排行榜》，公司在综合 PCB100 强中排名第 23 位，内资 PCB100 强中排名第 10 位。

(2) 印制电路板行业产值规模及分布

2023 年，在国际形势多变的大环境影响下，全球经济承压，印制电路板产业所受影响也较为显著。根据 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 市场产值同比减少 15%，达 695.17 亿美元。但从中长期来看，随着人工智能、汽车电子、云计算等下游应用行业的拓展，进而直接或间接地带动了 PCB 产业的发展，全球 PCB 行业在 2023 年至 2028 年复合增长率为 5.4%，总体保持平稳增长。

根据 Prismark 预测，未来几年，中国仍将是 PCB 行业的主要制造中心。2023 年国内 PCB 市场产值达 377.94 亿美元，同比下降 13.2%。预测 2023 年至 2028 年总体保持增长，但预期会出现一些生产转移，复合增长率为 4.1%，低于全球增速。Prismark 预计未来五年各个国家和地区的 PCB 产值增长情况如下：

单位：亿美元

国家和地区	2023E	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2023-2028 复合增长率
中国大陆	377.94	393.41	411.24	428.63	445.32	461.80	4.1%
日本	60.78	63.16	67.26	71.28	75.33	79.04	5.4%
美洲	32.06	33.04	34.58	35.93	37.25	38.55	3.8%
欧洲	17.28	17.54	18.24	18.87	19.46	20.02	3.0%

国家和地区	2023E	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2023-2028 复合增长率
亚洲（除中国大陆、日本）	207.10	222.56	242.26	262.24	283.26	304.72	8.0%
合计	695.17	729.71	773.58	816.95	860.62	904.13	5.4%

数据来源：Prismark

（3）印制电路板行业产品结构及需求变化

根据 Prismark 统计，受需求疲软、供过于求进而形成库存调整、竞争加剧等问题的影响，2023 年每个 PCB 产品结构均出现不同程度的负增长，其中封装基板下滑最为严重。中长期来看，18 层以上多层板、HDI 和封装基板将保持相对较高的增长，2023 年至 2028 年复合增长率分别达到 7.8%、6.2%和 8.8%，高于总体增长。Prismark 的统计及预测情况如下：

单位：亿美元

产品结构	2023	2023 年增长率	2024	2028	2023-2028 年复合增长率
单/双面板	77.57	-12.6%	79.49	90.23	3.1%
4-6 层	154.69	-12.0%	159.78	182.91	3.4%
8-16 层	94.55	-10.4%	99.86	123.44	5.5%
18 层以上	16.10	-6.5%	17.47	23.49	7.8%
HDI	105.36	-10.4%	110.95	142.26	6.2%
封装基板	124.98	-28.2%	135.68	190.65	8.8%
软板	121.91	-11.9%	126.49	151.17	4.4%
合计	695.17	-15.0%	729.71	904.13	5.4%

数据来源：Prismark

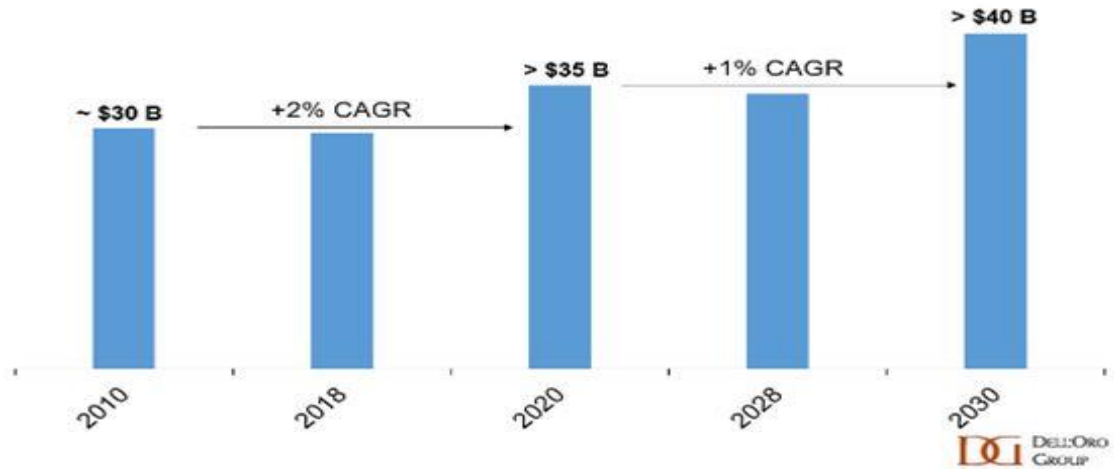
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

生益电子以印制线路板为主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建成了高精度 HDI 产线及软硬结合板产线。力求打造行业产品的全面覆盖，提升行业市场占有率，进一步增强公司核心竞争力。

通讯行业

2023 年，全球通讯领域需求不振，RAN（无线接入网）市场在 2021 年已经达到顶峰，预计将在 2023 年和 2024 年下降。虽然预计下降的速度将在 2024 年放缓，但随着印度的发展形势向负面倾斜，情况仍将充满挑战。网络领域在 2023 年上半年同样需求疲软，但随着 AI 产品的带动，已有回暖迹象，预计 2024 年有望提升。

Global RAN Revenue



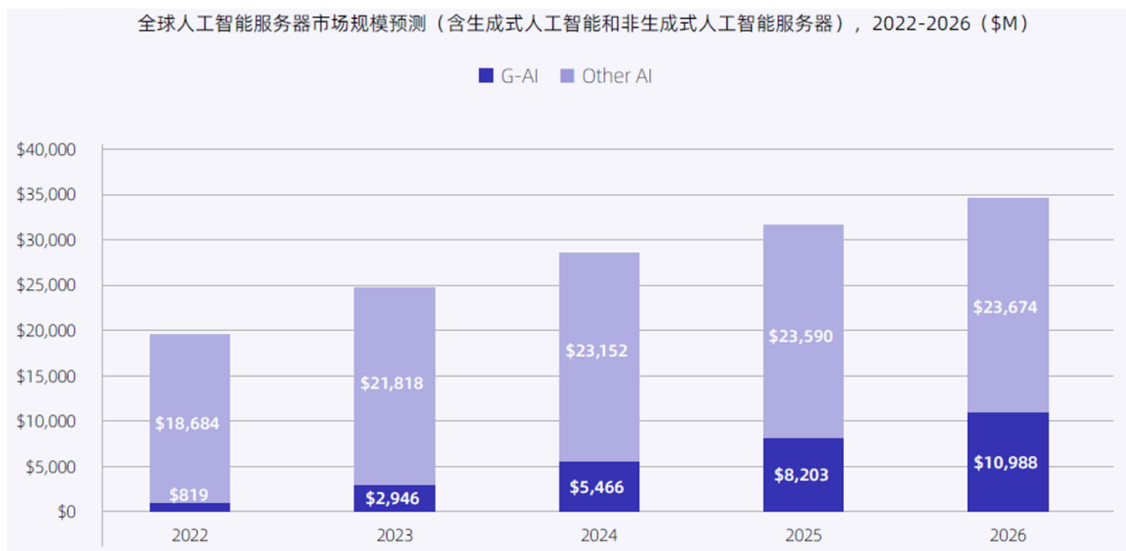
来源：Dell'Oro Group

报告期内，公司根据大环境提前作出研判，适时对价格进行了合理的调整，从而保持了相应的市场份额。另外，生益电子依旧保持在通讯网络高端产品上的研发投入，持续与业内头部企业紧密合作，目前正积极配合客户进行 5.5G、6G、卫星通讯、800G 交换机、光模块等应用领域 PCB 产品的开发工作，预计 2024 年能够陆续实现批量生产，有望提升产品单价。

服务器行业

服务器市场是全球数据经济的晴雨表，2023 年全球经济面临压力，经济增长放缓，高通胀问题仍然存在，不利的经济环境对 2023 年全球服务器市场产生一定的冲击，服务器出货量明显放缓。

虽然整体服务器市场形势不佳，但 AI 服务器成为新的增长点。根据 IDC 预测，2023 年全球 AI 服务器市场规模为 247.64 亿美元，同比增长 26.98%；预计 2026 年达 346.62 亿美元，2022-2026 年复合增长率达 15.5%。



来源：IDC

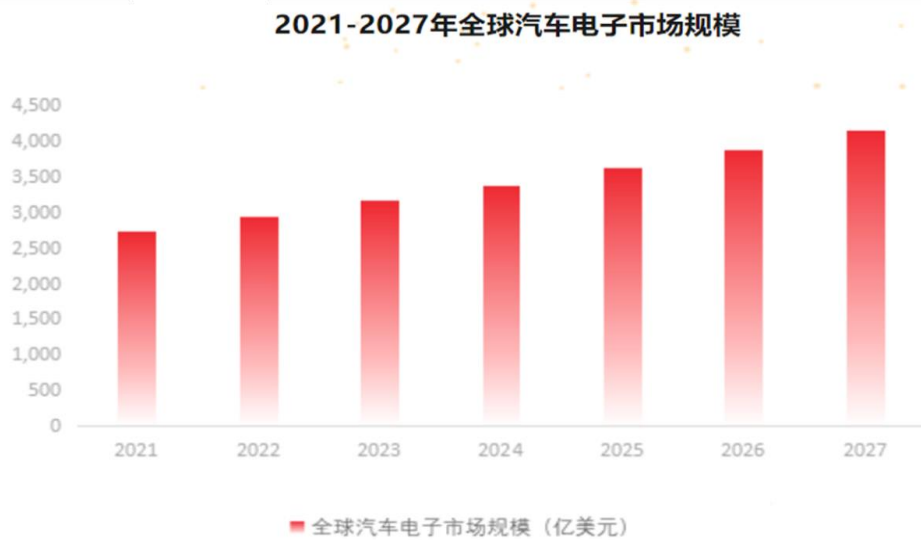
高端服务器的要求一般为高层、高密、高速等，这将带动 PCB 产品的价值的提升。公司一直将服务器市场作为核心下游市场之一，一直与行业龙头企业保持紧密合作，持续优化服务器领域产品结构，积极配合终端客户进行服务器产品的开发工作。报告期内，公司紧抓 AI、高性能计算

机等领域相关产品研发，目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI 配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对 AI 产品的产能将进一步扩大。2023 年全年来看，上半年库存过高的影响已经基本解决，服务器产品的销量及占比也在下半年得到明显回升。随着 AI 产品需求的持续上升，公司 AI 服务器项目有望在 2024 年继续保持增长。

汽车电子行业

汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约 28%，在新能源车中则能达到 47%-65%。智能座舱、智能辅助驾驶、能源管理系统等相关汽车电子产品需求持续增长。

根据 GGII 预测，2023 年，全球新能源汽车销量将突破 1500 万辆；预计 2024 年，全球新能源汽车销量有望突破 1800 万辆，全球汽车电动化渗透率将接近 20%，新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求。从市场调研数据来看，预计 2024 年汽车电子市场将稳定增长，同比增长保持在 4% 左右。



来源：汉鼎智库

在报告期内，公司在汽车电子领域继续加大研发投入，提升相关产品的工艺技术能力。随着公司深入开拓汽车电子市场以及吉安生益一期全面投产和东城四期的投产提产，汽车电子产品营收规模同比实现较大增长，汽车电子产品占比从去年同期的 11% 大幅提升至 17%。更多新客户的认可及批量订单导入也在持续进行。

未来，公司将持续加大在汽车专线的投入，以应对日益增长的汽车 PCB 订单需求。随着汽车电子的快速升级，业界对 PCB 的技术要求也在不断提升，越来越多高端工艺技术被用于 PCB 生产制造中。公司针对智能辅助驾驶、动力能源及智能座舱等产品线将会不断开展更多新技术研发及产品认证。

智能终端行业

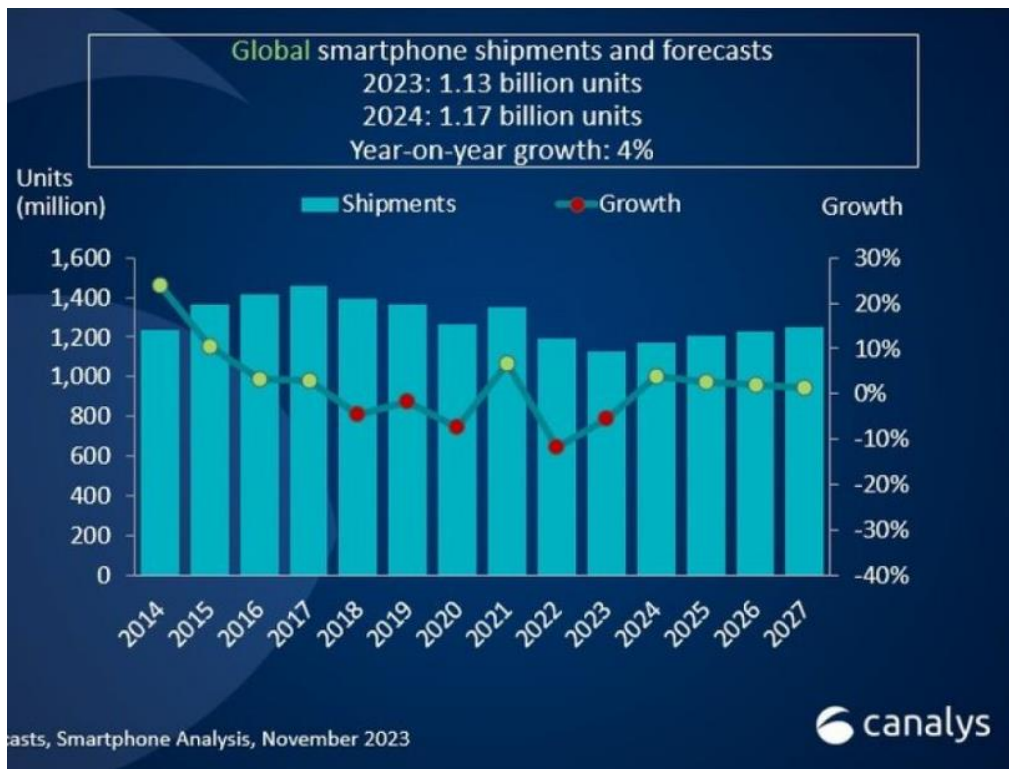
智能终端行业面对产业链上下游相对高企的库存，以及消费者对电子产品消费的“迟疑”，近两年市场状况并不乐观。随着逐渐去库存化以及换机需求的到来，预期 2024 年有望重拾增长动力。

据市场分析机构 Canalys 预测，全球个人电脑出货量在连续七个季度下跌后有望迎来复苏，2024 年全年出货量预计达到 2.67 亿台，较 2023 年增长 8%。



来源：Canalys

据市场分析机构 Canalys 预测，2023 年全球智能手机出货量估计为 11.3 亿部，与 2022 年相比下降 5%。2024 年全球智能手机出货量预计为 11.7 亿部，与 2023 年相比预计上涨 4%。



来源：Canalys

公司在智能终端有一定的客户积累，但以前主要受到相关产线瓶颈的限制。随着公司 HDI 和软硬结合板产能的释放以及在相关产品线投入的增加，叠加未来市场逐渐转好的预期，生益电子将加大在终端产品线的市场开发力度以拓宽客户群体，智能终端业务有望逐步增大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	6,284,056,602.79	6,961,317,142.77	-9.73	6,428,296,588.39
归属于上市公司股东的净资产	3,926,700,668.03	4,084,111,699.61	-3.85	3,903,893,231.14
营业收入	3,273,012,827.91	3,534,688,853.21	-7.40	3,647,394,627.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,263,926,288.74	3,525,901,271.04	-7.43	3,638,588,170.12
归属于上市公司股东的净利润	-24,993,631.93	312,909,308.68	不适用	264,273,119.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,664,946.38	273,270,603.45	不适用	228,277,924.97
经营活动产生的现金流量净额	431,380,829.09	741,041,313.70	-41.79	421,454,567.51
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	7.88	不适用	7.48
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.38	不适用	0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.38	不适用	0.33
研发投入占营业收入的比例(%)	5.89	5.53	增加0.36个百分点	5.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	742,604,987.42	840,427,758.90	808,061,577.74	881,918,503.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,008,036.13	13,579,328.59	-27,218,183.35	-7,346,741.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,299,416.52	9,918,914.38	-30,097,825.02	-16,186,619.22
经营活动产生的现金流量净额	215,475,877.93	43,749,262.02	99,617,778.46	72,537,910.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		15,572						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		16,006						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		不适用						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
广东生益科技股份 有限公司	0	523,482,175	62.93	523,482,175	523,482,175	无	0	境内非国 有法人
东莞市国弘投资有 限公司	1,740,088	66,368,088	7.98	0		无	0	国有法人
广东省广新控股集 团有限公司	0	13,170,860	1.58	0		无	0	国有法人
新余腾益投资管理 中心(有限合伙)	-4,075,00 0	12,233,000	1.47	0		无	0	境内非国 有法人
新余超益投资管理 中心(有限合伙)	-3,680,60 0	11,052,400	1.33	0		无	0	境内非国 有法人
新余联益投资管理 中心(有限合伙)	-3,599,60 0	10,807,200	1.30	0		无	0	境内非国 有法人
新余益信投资管理 中心(有限合伙)	-3,371,70 0	10,122,300	1.22	0		无	0	境内非国 有法人
国泰基金管理有限 公司-社保基金 1102 组合	9,685,970	9,685,970	1.16	0		无	0	境内非国 有法人
伟华电子有限公司 -自有资金(R)	0	9,343,310	1.12	0		无	0	境外法人
东莞科技创新金融 集团有限公司	0	8,404,110	1.01	0		无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例均不足 30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。</p> <p>3、东莞科技创新金融集团有限公司，间接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例不足 30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。</p> <p>4、除此之外，公司前十名股东中，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

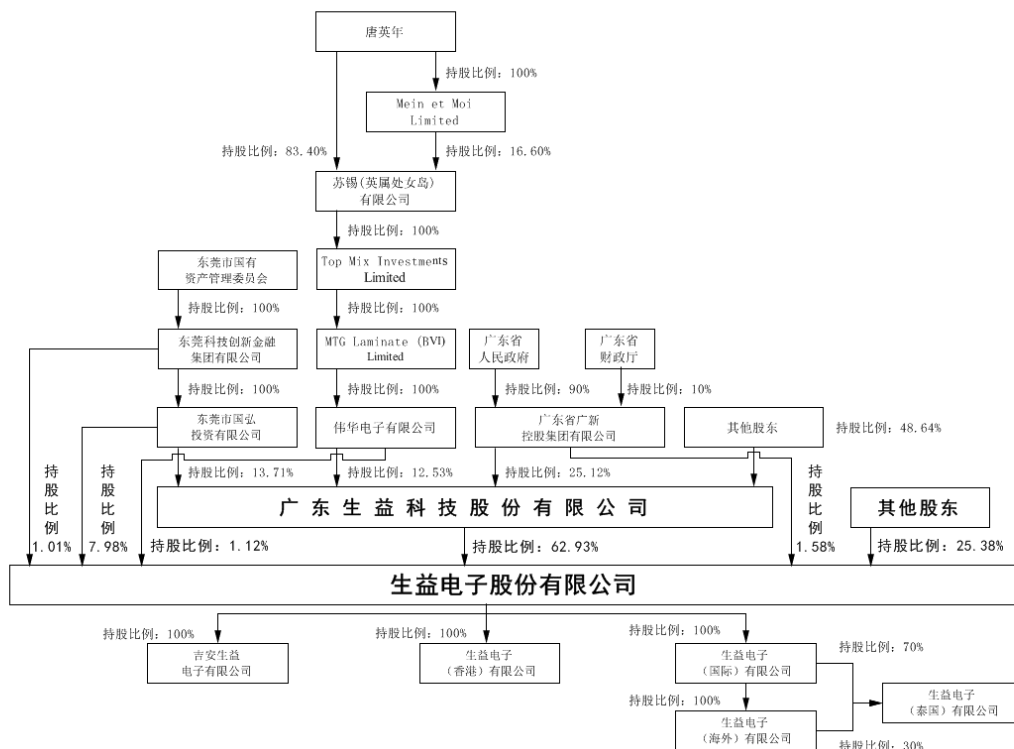
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，生益电子股份有限公司生产印制电路板 127.85 万平方米，比上年同期增加 11.73%；销售印制电路板 126.42 万平方米，比上年同期增加 12.36%。实现营业收入为 3,273,012,827.91 元，比上年同期减少 7.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用